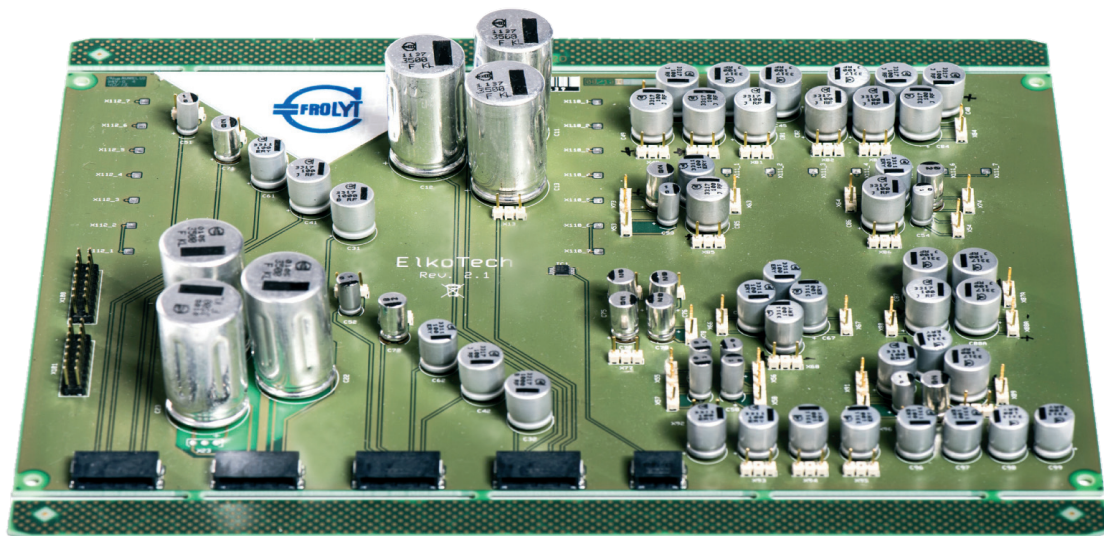


Radiale Elektrolytkondensatoren entwickelt für „PIN-IN-PASTE“

In einem Gemeinschaftsprojekt mit IMM Elektronik GmbH, Mittweida, TU Dresden, Institut für Aufbau- und Verbindungstechnik und FROLYT Freiberg wurden Test-Board-Untersuchungen mit den entwickelten Elektrolytkondensatoren und dem „PIN-IN-PASTE“ Verfahren durchgeführt. Dabei entstanden die Technologieentwicklung, Analytik und Gewinnung von Zuverlässigkeitsaussagen.



Mischbestückte Leiterplatten, die sowohl SMD- und THT- Komponenten enthalten, durchlaufen gewöhnlich zwei Lötprozesse (Reflow und Welle). Um Kosten zu sparen, bietet die „PIN-IN-PASTE“ Technologie eine der effektivsten Lösungen. Neben den SMD-Komponenten werden die Durchsteckbauelemente bestückt und im optimierten Reflowprozess gelötet. Standardelektrolytkondensatoren, welche bisher mit Wellenlötung verarbeitet wurden, sind für den Reflowprozess ungeeignet.

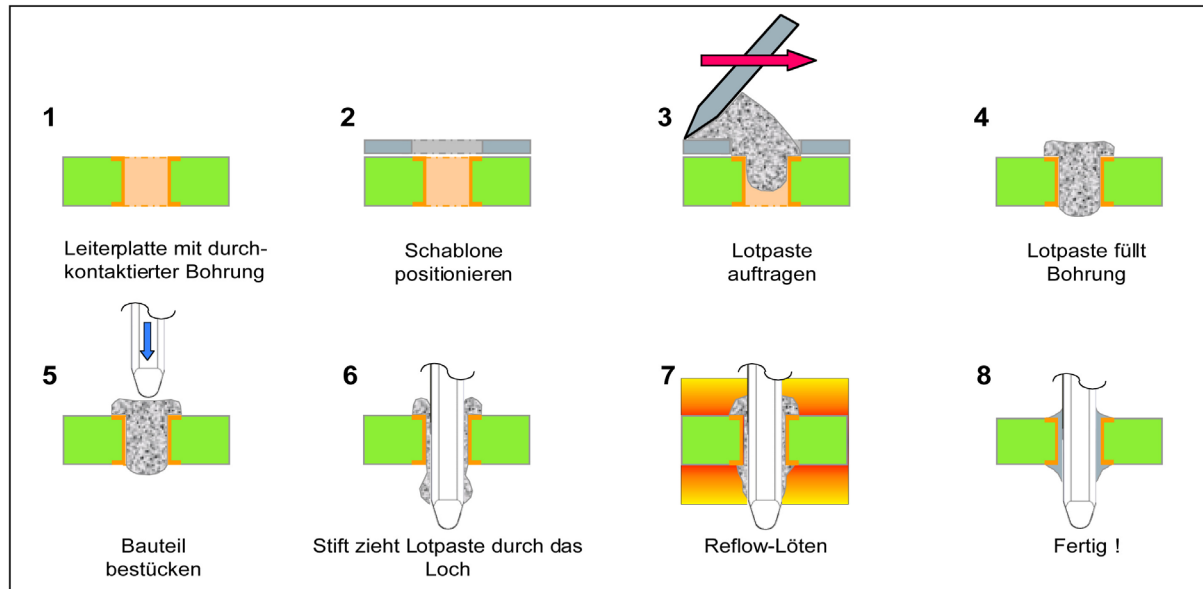
FROLYT hat spezielle wärmebeständige Elektrolytkondensatoren entwickelt, welche auch die Wärmezufuhr in die Durchkontaktierungen der Leiterplatte beim Reflowprozess unterstützen.

Die Spezialkondensatoren sind lieferbar in den Abmessungen
Ø 5,5 x 12,0 mm bis Ø 18,0 x 36,5 mm.



Through-Hole-Technik

Die Schritte des „PIN-IN-PASTE“-Verfahrens



Bildquelle: Phoenix Contact GmbH & Co. KG